

A. Interconnect & Package 분과

Room G

하나스퀘어 (B112)

일 시 : 2월 17일(금) 11:20-12:35

세션명 : [FH2-A] 패키징 세션 II

좌 장 : 황태주(삼성전자), 박영배(안동대학교)

-
- FH2-A-1 11:20-11:50 **[Invited]** Patterning Technologies of Organic Package Substrate
저자: 조순진
소속: 삼성전기 ACI 사업부
- FH2-A-2 11:50-12:05 A Self-Convection 3D IC Cooling System using a Micro Flat Heat Pi for Portable Devices
저자: 김남재, 김시호
소속: School of Integrated Technology and Yonsei Institute of convergence technology
- FH2-A-3 12:05-12:20 The Effects of a Ni(P)/Cu Diffusion Barrier on Reliabilities of Cu/Sn/Cu Bonding
저자: 이병훈, 이후정
소속: 성균관대학교 신소재공학과
- FH2-A-4 12:20-12:50 **[Invited]** LED Package 기술 동향
저자: 황성덕
소속: 삼성LED 연구소 연구¹팀